(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205110269 U
(45)授权公告日 2016.03.30

(21)申请号 201520903629.7

(22)申请日 2015.11.14

(73)专利权人 湖南城市学院
地址 413099 湖南省益阳市迎宾东路518号

(72)发明人 陈卫民

(74)专利代理机构 北京高航知识产权代理有限公司 11530
代理人 赵永强

(51)Int.Cl.
B08B 5/04(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)

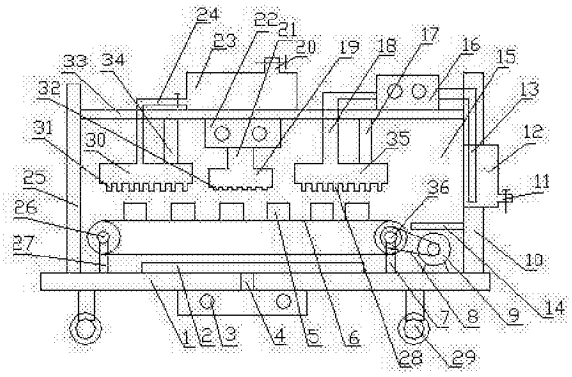
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，包括底座板、左立柱、右立柱、处理腔、顶板、供气腔、上热风机、吸尘器、电机和下热风机，左立柱和右立柱分别固定连接在底座板上部左右两侧位置，处理腔设置在左立柱和右立柱中间位置，顶板设置在处理腔上部位置且左右两侧分别与左立柱和右立柱相连接；处理腔下部左右两侧分别固定连接有左支撑柱和右支撑柱，左支撑柱和右支撑柱上部分别设置有左辊轮和右辊轮，左辊轮和右辊轮之间连接有输送带，输送带上部设置有多个计算机电子芯片。该实用新型装置能有效地针对计算机电子芯片表面进行绝缘处理，改善了绝缘处理效果，并方便防潮处理，且能针对芯片进行除尘处理，使用方便。



CN 205110269 U

1.一种计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，其特征在于：包括底座板、左立柱、右立柱、处理腔、顶板、供气腔、上热风机、吸尘器、电机和下热风机，所述左立柱和右立柱分别固定连接在底座板上部左右两侧位置，所述处理腔设置在左立柱和右立柱中间位置，所述顶板设置在处理腔上部位置且左右两侧分别与左立柱和右立柱相连接；所述处理腔下部左右两侧分别固定连接有左支撑柱和右支撑柱，所述左支撑柱和右支撑柱上部分别设置有左辊轮和右辊轮，所述左辊轮和右辊轮之间连接有输送带，所述输送带上部设置有多个计算机电子芯片，所述电机设置在底座板上部右侧位置，所述电机和右辊轮之间连接有传动带；所述供气腔设置在顶板上部左侧位置，所述供气腔上部连接有进气管，所述供气腔左侧连接有供气管，所述供气管下部连接有出气腔，所述出气腔下部连接有多个出气管，所述上热风机固定设置在顶板下部中间位置，所述上热风机下部连接有上供风管，所述上供风管下部连接有上出风腔，所述上出风腔下部连接有多个出风管，所述吸尘器设置在顶板上部右侧位置，所述吸尘器左侧连接有进尘管，所述进尘管下部连接有进尘腔，所述进尘腔下部连接有多个吸尘管，所述吸尘器右侧连接有出尘管，所述右立柱中间位置设置有集尘腔，所述出尘管下端设置在集尘腔内部，所述集尘腔右侧连接有排尘管，所述下热风机设置在底座板下部中间位置，所述下热风机上部连接有下供风管，所述下供风管上部连接有下出风腔。

2.根据权利要求1所述的计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，其特征在于：所述出气腔上部右侧固定连接有左连接杆，所述左连接杆上部与顶板下部左侧相连接。

3.根据权利要求1所述的计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，其特征在于：所述进尘腔上部右侧固定连接有右连接杆，所述右连接杆上部与顶板下部右侧相连接。

4.根据权利要求1所述的计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，其特征在于：所述右立柱左侧下部固定连接有存放板。

5.根据权利要求1所述的计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，其特征在于：所述底座板下部左右两侧均设置有移动轮。

计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于计算机技术领域，具体涉及一种计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统。

背景技术

[0002] 目前，计算机芯片是计算机的核心，它能完成几乎是计算机所有的工作，如运算、数据处理、数据传输、存贮、分析等等，是计算机能正常运行的基础。空气中的灰尘会堆积在计算机芯片表面，影响计算机芯片的外观。灰尘和它吸附的水分还会对计算机芯片造成腐蚀，导致计算机芯片损坏，造成大量的经济损失。因此需要对计算机芯片表面进行绝缘、除尘和防潮处理，减少外部因素对计算机芯片造成的破坏，对计算机芯片进行保护。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，以便更好地改善计算机电子芯片的表面处理效果，方便更好地绝缘和防潮处理，改善了使用效果。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下。

[0005] 一种计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，包括底座板、左立柱、右立柱、处理腔、顶板、供气腔、上热风机、吸尘器、电机和下热风机，左立柱和右立柱分别固定连接在底座板上部左右两侧位置，处理腔设置在左立柱和右立柱中间位置，顶板设置在处理腔上部位置且左右两侧分别与左立柱和右立柱相连接；处理腔下部左右两侧分别固定连接有左支撑柱和右支撑柱，左支撑柱和右支撑柱上部分别设置有左辊轮和右辊轮，左辊轮和右辊轮之间连接有输送带，输送带上部设置有多个计算机电子芯片，电机设置在底座板上部右侧位置，电机和右辊轮之间连接有传动带；供气腔设置在顶板上部左侧位置，供气腔上部连接有进气管，供气腔左侧连接有供气管，供气管下部连接有出气腔，出气腔下部连接有多个出气管，上热风机固定设置在顶板下部中间位置，上热风机下部连接有上供风管，上供风管下部连接有上出风腔，上出风腔下部连接有多个出风管，吸尘器设置在顶板上部右侧位置，吸尘器左侧连接有进尘管，进尘管下部连接有进尘腔，进尘腔下部连接有多个吸尘管，吸尘器右侧连接有出尘管，右立柱中间位置设置有集尘腔，出尘管下端设置在集尘腔内部，集尘腔右侧连接有排尘管，下热风机设置在底座板下部中间位置，下热风机上部连接有下供风管，下供风管上部连接有下出风腔。

[0006] 进一步地，出气腔上部右侧固定连接有左连接杆，左连接杆上部与顶板下部左侧相连接。

[0007] 进一步地，进尘腔上部右侧固定连接有右连接杆，右连接杆上部与顶板下部右侧相连接。

[0008] 进一步地，右立柱左侧下部固定连接有存放板。

[0009] 进一步地，底座板下部左右两侧均设置有移动轮。

[0010] 该实用新型的有益效果在于：该实用新型装置能有效地针对计算机电子芯片表面

进行绝缘处理，改善了绝缘处理效果，并方便防潮处理，且能针对芯片进行除尘处理，使用方便。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型实施例中所使用装置结构示意图。

[0012] 图中标记说明：1、底座板；2、下出风腔；3、下热风机；4、下供风管；5、计算机电子芯片；6、输送带；7、右支撑柱；8、传动带；9、电机；10、右立柱；11、排尘管；12、集尘腔；13、出尘管；14、存放板；15、处理腔；16、吸尘器；17、右连接杆；18、进尘管；19、上出风腔；20、进气管；21、上供风管；22、上热风机；23、供气腔；24、供气管；25、左立柱；26、左辊轮；27、左支撑柱；28、吸尘管；29、移动轮；30、出气腔；31、出气管；32、出风管；33、顶板；34、左连接杆；35、进尘腔；36、右辊轮。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行描述，以便更好的理解本实用新型。

[0014] 如图1所示的计算机电子芯片表面绝缘防潮处理系统，包括底座板1、左立柱25、右立柱10、处理腔15、顶板33、供气腔23、上热风机22、吸尘器16、电机9和下热风机3，左立柱25和右立柱10分别固定连接在底座板1上部左右两侧位置，处理腔15设置在左立柱25和右立柱10中间位置，顶板33设置在处理腔15上部位置且左右两侧分别与左立柱25和右立柱10相连接；处理腔15下部左右两侧分别固定连接有左支撑柱27和右支撑柱7，左支撑柱27和右支撑柱7上部分别设置有左辊轮26和右辊轮36，左辊轮26和右辊轮36之间连接有输送带6，输送带6上部设置有多个计算机电子芯片5，电机9设置在底座板1上部右侧位置，电机9和右辊轮36之间连接有传动带8；供气腔23设置在顶板33上部左侧位置，供气腔23上部连接有进气管20，供气腔23左侧连接有供气管24，供气管24下部连接有出气腔30，出气腔30下部连接有多个出气管31，上热风机22固定设置在顶板33下部中间位置，上热风机22下部连接有上供风管21，上供风管21下部连接有上出风腔19，上出风腔19下部连接有多个出风管32，吸尘器16设置在顶板33上部右侧位置，吸尘器16左侧连接有进尘管18，进尘管18下部连接有进尘腔35，进尘腔35下部连接有多个吸尘管28，吸尘器16右侧连接有出尘管13，右立柱10中间位置设置有集尘腔12，出尘管13下端设置在集尘腔12内部，集尘腔12右侧连接有排尘管11，下热风机3设置在底座板1下部中间位置，下热风机3上部连接有下供风管4，下供风管4上部连接有下出风腔2。出气腔30上部右侧固定连接有左连接杆34，左连接杆34上部与顶板33下部左侧相连接。进尘腔35上部右侧固定连接有右连接杆17，右连接杆17上部与顶板33下部右侧相连接。右立柱10左侧下部固定连接有存放板14。底座板1下部左右两侧均设置有移动轮29。

[0015] 该装置在具体实施时，将计算机电子芯片5放置在输送带6上进行处理。启动电机9，电机9利用传动带8带动右辊轮36转动，右辊轮36带动输送带6转动，输送带6带动计算机电子芯片5向右移动。进气管20接通外部管道，打开进气管20和供气管24上的阀门开关，SF6气体从进气管20进入供气腔23，再从供气管24进入出气腔30。SF6气体最后从出气管31吹出，对下方的计算机电子芯片5进行绝缘处理。当输送带6将计算机电子芯片5向右输送到上

出风腔19下方时，利用上热风机22对空气进行加热后再将空气吹出。热空气从上供风管21进入上出风腔19，再从出风管32吹出，对下方的计算机电子芯片5进行干燥处理。当输送带6被输送到进尘腔35下方时，打开吸尘器16进行除尘，将计算机电子芯片5表面的灰尘从吸尘管28吸入进尘腔35，灰尘从进尘管18进入吸尘器16，再从出尘管13进入集尘腔12内进行收集，从而完成对计算机电子芯片5的除尘处理。当集尘腔12内收集的灰尘到一定量后，打开排尘管11上的阀门开关，灰尘从排尘管11排出进行处理。输送带6将计算机电子芯片5输送到右侧后，将计算机电子芯片5从输送带6上取下，放在存放板14上进行储存。打开下热风机3使其开始运行，下热风机3对空气进行加热，热空气从下供风管4进入下出风腔2后吹出，对上方的输送带6进行干燥处理，避免输送带6上的水分对计算机电子芯片5造成破坏。

[0016] 以上所述是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

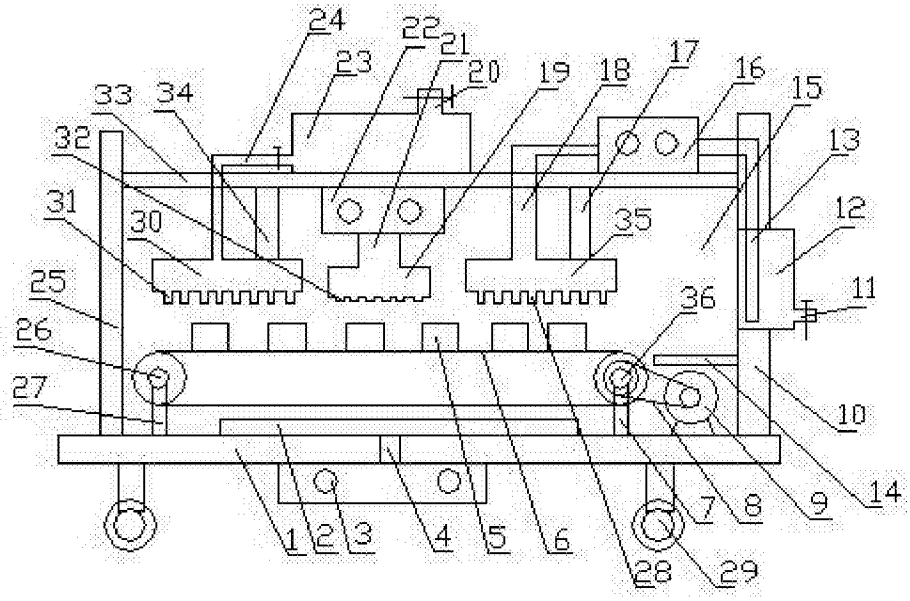

24
22
21
23
20
19
18
17
16
15
33
34
13
32
12
31
30
35
25
11
36
26
27
10
14
9
8
7
1
2
3
4
5
6
28
29

图1